

2025

华润微电子有限公司

“提质增效重回报” 行动方案

华 润 微 电 子 有 限 公 司

China Resources Microelectronics Limited

华润微电子有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长期投资价值基础，华润微电子有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，制定本行动方案，具体内容如下：

一、坚持 IDM 商业模式，以高质量发展铸就价值投资基础

2024 年，在人工智能、新能源汽车等新兴领域的带动下，全球半导体市场有所复苏，公司凭借产品、技术、客户等方面优势，持续加大研发投入，通过技术创新和差异化的竞争策略，积极应对市场需求的变化。报告期内，公司实现营业收入 101.19 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.62 亿元。

展望 2025 年，随着半导体行业库存回归至合理水位，叠加下游需求逐步回暖，公司将通过动态调整产能与产品业务结构，为业绩持续高质量增长聚势赋能。具体关键举措如下：

1. 高质高效推进重点项目，有力支撑产品升级

（1）重庆 12 吋功率半导体晶圆生产线项目

2024 年达成规划产能 3 万片/月。2025 年公司将充分发挥 12 吋晶圆产线技术优势和产能规模，加快中低压 MOSFET、高压 MOSFET 和 IGBT 高端产品开发与产业化，推动产品快速上量，并进一步提升市场占有率。

（2）深圳 12 吋集成电路生产线项目

2024 年底实现通线投产。2025 年产线进入爬坡期，公司将继续加快产品线开发进度与市场渠道建设。

(3) 先进功率封测基地

2024 年快速提升封测基地量产规模，封装各品类产能利用率较同期均实现较大幅度提升。2025 年公司将持续推动封测基地全面覆盖功率半导体产品模块封装、晶圆中道生产线、面板级封装、第三代半导体封装等技术领先门类，稳定生产工艺，进一步增加模块产品的产出及产值。

(4) 高端掩模项目

2024 年掩模业务已覆盖国内主流 6、8、12 吋的制版需求，完成 90-40nm 工艺技术平台搭建，90nm 产品实现量产交付，掩模新品良率始终保持在 98%以上，准时交付率近 100%。2025 年公司重点推进 12 吋线的客户认证，优化订单结构，充分挖掘新线盈利能力，持续推进高端掩模项目效益发挥。

2. 强化提质增效降本，深挖创效潜能

公司依托 IDM 商业模式的优势，系统性推进供应链国产化替代进程，近五年实现主材国产化率提升 30%、辅材国产化率增长 20%，在保障供应链安全的同时显著降低采购成本。同时，依托精益化管理与数智化转型，实现销售费用与管理费用同比分别下降 5.37%和 20.14%。

面向 2025 年，公司将围绕三大核心方向持续深化降本增效战略：一是供应链生态升级，深化产业链协同创新，通过搭建工艺验证平台加速主辅材料国产化进程，强化供应链体系抗风险能力。二是数智化转型深化，实施制造业数字化转型行动，实现业务发展与数字技术深度融合。三是全价值链精益管控，从技术、采购、制造、封测、能耗及质量等维度建立系统性降本机制，实现质量成本与资源效率的同步优化。

二、加快发展新质生产力，聚焦技术和产品创新

公司将新质生产力作为高质量发展核心引擎，以市场需求为导向强化核心技术攻关，持续提升自主创新能力，为推进高水平科技自立自强夯实根基。

1. 推动研发投入稳步增长

2024 年，公司研发投入达到 11.67 亿元，较上年同期增长 1.13%，研发投入占比达到 11.53%。2025 年公司研发投入仍将保持高位，彰显了公司对技术创新的高度重视，为后续成长提供了坚实支撑。

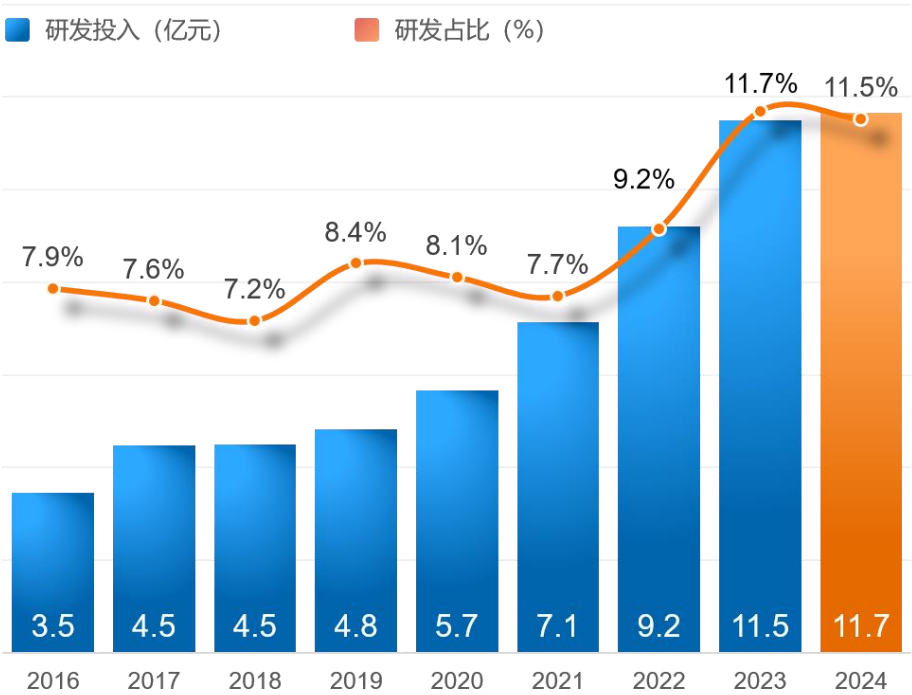


图 1：公司历年研发投入情况

2. 加速产品技术迭代

公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位，与国外厂商差距不断缩小。其中：

（1）MOSFET 产品：

2024 年，MOSFET 产品在汽车电子、工业、AI 服务器等中高端领

域销售进一步扩展，推动了产品应用全面化、高端化，保持产品在市场端的品牌影响力和规模优势。

2025 年，公司将充分发挥 12 吋技术领先优势，重点围绕中低压 MOSFET 分裂栅平台、高压 MOSFET 超结平台加速迭代升级，聚焦重点应用领域进一步丰富产品组合。

（2）IGBT 产品：

2024 年，IGBT 产品在工业（含光伏）、汽车电子领域销售占比超过 70%。基于 12 吋线成功开发的新一代 G7 平台，性能可对标国际一流水平。

2025 年，公司将充分发挥 8 吋和 12 吋晶圆生产线优势特点，加快 IGBT、FRD 技术平台升级，针对汽车电子、工业控制、新能源等领域，进一步丰富产品组合。发挥重庆模块封测基地优势，加快 IGBT 模块特别是车规模块的推广上量，保障全年业绩增长。

（3）第三代宽禁带半导体：

2024 年，第三代半导体整体销售收入同比保持快速大幅增长。碳化硅产品在新能源汽车、充电桩、光储逆变、数据中心电源、工业、消费等领域头部客户稳定供货。氮化镓产品供应持续扩大行业头部客户群体，大功率工控类产品陆续进入量产阶段，外延中心建设有序推进中。

2025 年，公司将继续加快碳化硅和氮化镓技术平台迭代和系列化，为汽车电子、数据中心、充电桩、光储逆变、高端消费等核心市场客户提供优异性价比的产品组合。加速产业化进程，持续扩大客户群和市场份额，营收规模保持快速增长。

（4）功率 IC、智能传感器及智能控制产品：

2024 年，公司全力推进在汽车电子与新能源领域的市场规划布局，多颗车规级芯片顺利通过 AEC - Q100 车规考核认证之后，又成功获取 ISO 26262 功能安全管理体系的最高等级 ASIL D 认证，多颗产品荣获 UL 认证。抗量子计算的安全 MCU 顺利通过国家密码管理局商用密码检测中心安全认证，符合安全芯片密码检测准则第二级的要求，荣获国资委第四届中央企业熠星创新创业大赛一等奖。

2025 年，公司聚焦汽车电子、高端家电、AI 服务器电源等核心领域持续发力，实现产品系列化及前瞻性开发。同时，将安全 MCU 产品延伸至中高性能系列产品的研发范畴，可进一步应用于智能网联汽车、网络安全以及金融安全等诸多场景。

序号	项目名称	技术水平	具体应用前景
1	汽车级SiC MOSFET设计及工艺研发	国际先进	新能源汽车车驱应用领域
2	SiC沟槽MOS器件及工艺研发	国内领先	应用于光伏逆变器、风电逆变器，UPS电源、电动汽车、充电桩、车载充电机，轨道交通驱动，电信和服务器电源
3	抗量子计算可重构安全MCU研发	国际先进	面向工业控制和汽车电子应用的安全MCU，包括智能表计/智能家居、物联网/工业互联网、网络安全、汽车电池安全认证、汽车车联网等领域
4	异构集成方式制造MEMS产品及其技术研发	国际领先	应用于智能手机、智能音响设备、医疗设备，智能汽车与智能交通等新的应用领域
5	高性能多电机控制32位MCU项目	国内领先	聚焦家电、工控及消费电子应用
6	第二代VFRAM器件和嵌入式IP技术研发	国内领先	应用于汽车电子辅助驾驶、工控机器人、车载记录仪、智能仪表等领域

图 2：公司在研项目

展望未来，公司将继续秉承以科技创新驱动公司高质量发展的原则，持续强化核心产品与技术的研发投入，着力提升产品竞争力和市场占有率。依托自身资源优势，持续调整优化产业结构布局，完善产业协同互补，放大全产业链效应。同时积极推进前瞻性研发项目的实

施，加快关键核心技术攻关，构筑科技创新多元化的应用领域布局。

3. 推动下游应用向高端转型

2024 年，公司顺应市场发展趋势，聚焦产品在终端应用领域的高端化转型，技术水平与市场份额同步攀升，在泛新能源领域（新能源及汽车电子）取得了令人瞩目的成绩，在公司产品与方案板块占比达到了 41%。其中在汽车电子领域，公司已与多家头部整车厂、Tier1 厂商形成了战略合作关系，推出包括 MOSFET、IGBT、碳化硅、功率 IC 等在内的系列化车规级产品，批量应用于动力、底盘、车身、辅助驾驶等多个整车应用场景。



图 3： 2024 年公司产品与方案板块下游终端应用情况

2025 年，华润微电子将紧抓国家“双碳”战略与新质生产力发展机遇，深度聚焦新能源汽车、光储一体化、AI 服务器及智能终端消费品等战略赛道，充分发挥 IDM 协同优势及功率半导体领域综合竞争优势，加速推进高端化产品矩阵建设，保障产品组合不断丰富以满足下游场景迭代需求，在强化市场占有率的同时提升高附加值产品占比，驱动营收规模与经营质量实现双重提升。

三、以奋斗者为本，深入实施人才强企战略

公司构建“战略锚定-组织适配-人才驱动”三位一体的人才发展

体系。2024 年基于战略布局及重点项目需求，一方面多渠道引进中高端技术骨干及管理人才，深化“1+3+N”校企合作模式，加强与多所国内知名高校开展校企合作，探索高校人才双向聘用机制，并开展工程硕博联合培养项目，积极储备高校专业技术人才，推动公司成为引才聚才、育才用才的标杆示范。另一方面，强化培育与激励双轨并行，探索战新薪酬机制，搭建覆盖研发、工艺、品控全链条的阶梯式培训系统，形成引进、培养、考核、晋升的人才闭环管理。

2025 年公司将持续完善科技创新激励机制，激活科技人才创新基因，驱动业绩贡献。一是深化组织重塑，重点开展公司管理、产品能力方面的组织重塑。二是着力引进高层次人才，重点培养科技领军人才。三是探索创新路径，通过成立学习与创新中心，推广创新方法论和实践开展创新主题活动。四是持续落实股权激励行权，持续探索科技人才激励新机制。

四、以投资者为本，与投资者共享发展成果

公司重视投资者的合理投资回报，坚持每年稳定现金分红，自公司上市以来，累计现金分红合计约 7.74 亿元，践行了长期价值共享承诺。

2025 年，在行业周期性调整与重大项目资本开支双重压力下，公司仍坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红政策。2025 年 4 月 28 日，公司董事会审议通过了《2024 年度利润分配方案》，计划于 2025 年年中实施 2024 年度利润分配方案。

基于提升上市公司市值管理的政策导向，公司以提高公司质量为基础，制定《华润微电子有限公司市值管理制度》，并于 2025 年 4 月颁布实施，旨在进一步推动公司投资价值提升、增强投资者回报。

2025 年，公司将持续关注市值健康度与投资者回报率，建立稳定股价预案。以稳健经营为核心，做好价值创造、价值传递、价值释放，提振市场信心，积极维护市值稳定，同时努力提升盈利能力，为投资者创造长期价值。

五、完善公司治理，以卓越董事会实现高效管理

1. 秉持“高标准、严要求”规范并实现高质量信息披露

2024 年度公司共披露了 54 份公告文件，合计约 100 万字，积极提升信息披露价值传递和透明度。在 2022 至 2024 年连续两个年度科创板信息披露工作评价中，均荣获 A 级最高评价。

2025 年公司将继续严格依据相关法律法规以及公司《章程》和《华润微电子有限公司信息披露事务管理制度》等规章制度，高质量履行信息披露义务，力争优秀评价。

2. 完善公司治理制度

2024 年公司完成修订《章程》《华润微电子有限公司股东会议事规则》《华润微电子有限公司董事会议事规则》等若干项公司治理制度，新增《华润微电子有限公司董事长行使董事会授权工作规则》，同时梳理了《董事会授权决策事项清单》，并根据最新情况进行了合理授权，完善公司治理管理流程，完成决策事项清单、权责运行手册梳理修订工作。

2025 年公司将对齐相关法律法规的最新要求，根据《董事会授权决策事项清单》及自身实际经营需要，进行合理授权，持续完善公司治理有关制度及管理流程。

3. 强化外部董事和独立董事履职

2024 年公司积极配合董事参与公司重要会议及相关培训，外部

董事平均履职天数 93 天，其中现场履职天数 33 天；独立董事平均履职天数 42 天，现场履职天数 15 天。

2025 年将进一步保障董事履职条件，及时向董事传递公司收集的
行业信息等资料，安排重点项目调研与核心团队交流，确保外部董
事充分履行各项职权，为公司高质量发展提供专业支撑。

4. 持续落实经理层向董事会报告机制

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 8 月 30 日召开第二届董
事会第十五次会议和第二届董事会第十六次会议。两次会议中，公司
时任总裁李虹博士分别就 2023 年度及 2024 年半年度履职情况向董事
会作总结汇报。

2025 年将有序完成董事会换届衔接，保障治理机制平稳过渡与
战略决策连续性，持续强化董事会战略督导与经理层执行效能的双向
协同。

六、合规严谨做好投关管理，多措并举提高上市公司质量

公司高度重视投资者关系管理工作，坚持以“透明化沟通”为核
心，多渠道加强与投资者互动。

1. 强化投资者互动

投关团队通过策略会、路演、接待来访等多种途径与投资者保持
互动，2024 年累计开展超百场投资者交流活动，覆盖机构超千家。
同时，积极推动投资者交流的国际化，通过参加国际半导体行业会议、
投资论坛及路演活动，强化与香港、新加坡、欧洲、中东等国际投资
机构、分析师的深度交流，建立长期沟通机制。

2025 年 1 月 9 日，公司举办第三届“华启未来 润芯同行”投资者开放日暨新品发布会。管理层携市场、产品条线负责人，与投资者围绕战略规划、经营亮点、工艺创新、汽车电子及 AI 等领域布局展开深度对话，全面展现公司的创新实力与战略发展蓝图。



2. 完善沟通渠道

通过官方网站投资者关系专栏、社交媒体官方账号、投资者热线及电子邮箱等多元化沟通渠道，确保投资者能够方便快捷地获取公司信息并反馈意见。投关团队收集、整理投资者意见，及时向管理层反馈，形成双向沟通的良性循环。通过“上证 e 互动”平台答复投资者提问 103 次，答复率 100%。

3. 提升团队专业性

不断提升投资者关系团队专业性，致力于做研究型 IR。构建集金融知识、产业经验、沟通技巧和证券法规等综合战略型投关能力，

提升包括行业数据库、下游细分市场数据库等研究型投关能力，为投资者提供更好的服务。

2024 年公司在资本市场集中斩获多个奖项，获评第七届中国卓越 IR“最佳资本市场沟通奖”、科创板开市五周年“最佳董事会秘书”、财联社第七届投资年会“最具投资价值奖”等，标志着公司在投资者管理、公司治理、投资价值等维度获得专业机构高度认可。

2025 年，公司将始终以投资者需求为导向，以市值管理和提升公司价值为目标，高频次、多维度持续向资本市场和社会大众传递公司经营理念和投资价值，建立与华润微行业地位、社会形象相符合的优质资本市场形象。具体工作方面，将继续围绕三大重点深化投资者关系管理：

第一，打造“投资者开放日”系列品牌活动，通过产线参观、技术展示和新品发布等场景，直观传递公司投资价值。

第二，建立高效沟通机制，在业绩披露后及时召开业绩说明会，向机构及个人投资者深度解读业绩及经营成果，全年确保不少于 4 次。

第三，加速推进投资者国际化，针对海外投资者开展线上线下路演，组织海外投资者实地调研，持续提升国际资本市场认知度。

七、全面贯彻“ESG”理念，坚定执行“双碳”战略

1. 改进工作路径，加强纵深管理，提高社会责任/ESG 评级

2024 年在董事会战略与可持续发展委员会的指导下，公司对各事业群 ESG 工作加强了纵深管理，提升公司整体的 ESG 管理与实践工作，也进一步提高了上市公司报告内容的深度和丰富度。公司在中国企业社会责任报告评级专家委员会评价，由 2023 年的四星级提升为四星半级；在万得（Wind）ESG 评级由 BBB 级提升至 A 级。

2. 主动对标优秀同行，关注 ESG 重点议题评分提升

公司重视 ESG 评级，对标国际、国内权威机构的评级结果，形成重点议题的对标报告。针对平均水平以下的指标及半导体特殊指标，对标优秀同行，召开专项提升会议，并扎实推进改进举措。制定形成了《华润微电子供应商商业行为准则》、《华润微电子负责任矿物声明》等文件，以加强 ESG 风险管理。

3. 持续打造“暖芯”系列 ESG 品牌，扩大影响力

2024 年，公司规划落实“暖芯”系列行动实践，“暖芯护苗”助学行动帮扶 100 名困难学生；“暖芯植树”活动连续多年按期落地实施；联合腾讯 SSV 开展“暖芯科教”公益课程，为山区小学普及半导体知识。打造公司 ESG 品牌，彰显央企责任担当。

4. 领航行业指南编制，助力国内首份半导体行业 ESG 指南出台

公司兼顾国内外趋势，参考 SGDs、GRI、ISSB 等国际指标，不断提升报告内容及内部管理。同时立足国情，从 2024 年 10 月起，携手国内优秀半导体同行，领航国内首份本土化《CASS ESG6.0 之半导体行业指南》的编制。

2025 年，公司将持续夯实 ESG 管理与实践，力争在中国企业社会责任报告评级专家委员会评价等级进一步提升，具体举措如下：

第一，持续关注国内外权威机构评级结果，对标优秀同行，达成 ESG 重点议题评分提升。

第二，顺利发布《CASS ESG6.0 之半导体行业指南》，响应监管要求，促进半导体行业评级体系的发展和成熟。

第三，规划发布公司 ESG 品牌商标，系统化形成 ESG 行动方向。同时积极落实“暖芯”系列进阶举措，以“科教、助学”等为主要公

益实践，并进一步扩大 ESG 品牌影响力。

本公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到外部经济环境、行业市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。